

2023-2029年中国半导体行业 前景展望与投资前景报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2023-2029年中国半导体行业前景展望与投资前景报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202304/354477.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2023-2029年中国半导体行业前景展望与投资前景报告》共十章。首先介绍了半导体相关概念及发展环境，接着分析了中国半导体规模及消费需求，然后对中国半导体市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国半导体面临的机遇及发展前景。您若想对中国半导体有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一部分 基础篇

第一章 半导体产业概述

1.1 全球半导体产业概述

1.1.1 全球半导体产业发展历程

1.1.2 全球半导体产业景气循环

1.1.3 半导体产业在现代国民经济中的重要地位

1.1.4 半导体产业关联度分析

1.2 中国半导体产业概述

1.2.1 中国半导体产业发展历程

1.2.2 中国半导体产业市场概述

1.3 半导体产业链结构

1.4 半导体产品分类

1.5 半导体制造流程

1.6 半导体集成电路类别

第二章 全球及中国半导体市场分析

2.1 全球半导体市场分析

2.1.1 全球半导体市场分析

2.1.2 全球半导体应用领域分析

2.1.3 全球半导体资本支出分析

2.1.4 全球半导体产能分析
2.1.5 2022年全球半导体主要厂商排名
2.1.6 2022年全球主要半导体厂商投资分析
2.2 2019-2022年中国半导体市场分析
第二部分 产业链篇

第三章 全球及中国IC设计市场分析

3.1 IC设计行业概述
3.1.1 IC设计行业特点
3.1.2 IC设计流程
3.1.3 IC设计方法演进路线
3.1.4 SOC主要特性及关键技术
3.1.5 IC设计业务模式
3.1.6 IC设计竞争力影响因素
3.2 全球及中国IC设计行业发展概述
3.2.1 全球IC设计行业发展概述
3.2.2 中国IC设计行业发展概述
3.3 中国IC设计业SWOT分析
3.3.1 中国IC设计业优势（S）
3.3.2 中国IC设计业劣势（W）
3.3.3 中国IC设计业威胁（T）
3.3.4 中国IC设计业机会（O）
3.4 中国IC设计行业分市场分析
3.4.1 中国消费类IC设计市场分析
3.4.2 中国通信IC设计市场分析
3.4.3 中国工业控制类IC设计市场分析
3.5 中国IC设计厂商分析
3.5.1 大唐微电子
3.5.2 杭州士兰
3.5.3 中星微
3.5.4 珠海炬力
3.5.5 中国华大

- 3.5.6 南山之桥
- 3.5.7 北京北大众志
- 3.5.8 北大青鸟集成电路
- 3.5.9 北京海尔集成电路
- 3.5.10 北京华虹集成电路
- 3.6 中国IC设计投资分析

第四章 全球及中国IC制造市场概述

- 4.1 2019-2022年全球IC制造市场概述
- 4.2 2019-2022年中国IC制造市场概述
- 4.3 全球及中国主要IC制造厂商分析
 - 4.3.1 全球主要IC制造厂商
 - 4.3.1.1 台积电
 - 4.3.1.2 台联电
 - 4.3.1.3 新加坡特许半导体
 - 4.3.2 中国主要IC制造厂商
 - 4.3.2.1 中芯国际
 - 4.3.2.2 华虹
 - 4.3.2.3 上海宏力
 - 4.3.2.4 上海新进
 - 4.3.2.5 江苏和舰
 - 4.3.2.6 上海先进
 - 4.3.2.7 珠海南科
 - 4.3.2.8 中纬积体
 - 4.3.2.9 首钢日电
 - 4.3.2.10 华越微电子
- 4.4 全球四大晶圆厂对比分析
 - 4.4.1 全球四大晶圆代工厂经营状况比较
 - 4.4.2 全球四大代工厂商代工厂比较
- 4.5 小结

第五章 2019-2022年全球及中国IC封测市场分析

5.1 IC封测概述

5.1.1 IC封测概述

5.1.2 主要IC封装技术比较

5.1.3 IC封装发展趋势

5.2 全球IC封测概述

5.3 中国IC封测概述

5.4 中国主要IC封测厂商

5.4.1 江苏长电

5.4.2 北京自动测试技术研究所

5.4.3 南通富士通微

5.4.4 华越芯装

5.4.5 乐山菲尼克斯

5.4.6 宁波明昕

5.4.7 天水华天

5.4.8 北京微电子技术研究所

第六章 全球及中国半导体设备市场分析

6.1 半导体设备行业概述

6.2 世界半导体设备市场分析

6.3 中国半导体设备市场分析与预测

6.4 中国半导体二手设备市场分析

6.5 中国半导体设备主要厂商分析

6.5.1 七星华创

6.5.2 铜陵三佳电子

6.5.3 中电45所

6.5.4 中电48所

6.5.5 西北机器厂

6.5.6 兰州兰新

6.5.7 北京中科信

6.5.8 沈阳芯源

6.5.9 青岛旭升

6.5.10 商巨科技

第七章 全球半导体原材料市场分析

7.1 半导体原材料行业概述

7.2 全球半导体原材料市场分析

7.3 中国半导体原材料市场分析

7.4 中国半导体原材料主要厂商分析

7.4.1 有研硅股

7.4.2 上海合晶

7.4.3 万向硅峰

7.4.4 宁波立立

7.4.5 洛阳单晶硅

7.4.6 峨嵋半导体

7.4.7 浙大海纳

7.4.8 国瑞电子材料有限公司

7.4.9 北京化学试剂研究所

7.4.10 中电华威

第三部分 发展篇

第八章 中国半导体产业区域分析

8.1 长江三角洲

8.1.1 上海

8.1.2 江苏

8.1.3 浙江

8.2 京津环渤海湾

8.2.1 北京

8.2.2 河北

8.2.3 山东

8.2.4 辽宁

8.2.5 天津

8.3 珠江三角洲

8.3.1 深圳

8.4 西部地区

8.4.1 西安

8.4.2 四川

8.4.3 重庆

第九章 中国半导体产业环境分析

9.1 中国半导体产业投融资环境分析

9.2 中国半导体产业政府政策分析

9.2.1 全球主要国家半导体产业政策分析

9.2.2 中国半导体产业政策分析

9.3 中国硅知识产权（IP）产业分析

9.3.1 IP产业概述

9.3.2 IP基本概念与相关流程

9.3.3 IP市场前景分析

9.3.4 中国IP行业存在的主要问题

9.3.5 中国IP行业新进展

9.3.6 中国IP产业调查

9.3.7 小结

第十章 执行总结

图表目录：

图表 1 2019-2022年我国单晶硅材料供应分析

图表 2 2019-2022年我国氮化镓材料供应分析

图表 3 2019-2022年全球半导体行业总体规模

图表 4 2019-2022年全球集成电路行业总体规模

图表 5 2019-2022年全球半导体分立器件行业总体规模

图表 6 2019-2022年全球光电子器件行业总体规模

图表 7 英特尔经营情况分析

图表 8 德州仪器经营情况分析

图表 9 高通经营情况分析

图表 10 飞思卡尔经营情况分析

图表 11 AMD经营情况分析

图表 12 亚德诺半导体技术公司经营情况分析

图表 13 2022年日本电气股份有限公司经营情况分析

图表 14 2022年东芝经营情况分析

图表 15 意法半导体经营情况分析

图表 16 2022年三星电子经营情况分析

图表 17 2019-2022年我国半导体产业市场总规模分析

图表 18 2019-2022年我国集成电路产业市场总规模分析

图表 19 2019-2022年我国分立器件产业市场总规模分析

图表 20 idm商业模式

图表 21 垂直分工商业模式

图表 22 IP市场的收费模式

图表 23 IP核的硅验证及SOC验证

图表 24 2019-2022年我国集成电路设计行业发展规模分析

图表 25 2019-2022年我国集成电路制造行业发展规模分析

图表 26 2019-2022年我国集成电路封测行业发展规模分析

图表 27 2019-2022年我国集成电路行业企业数量分析

图表 28 2019-2022年我国集成电路行业资产规模分析

图表 29 2019-2022年我国集成电路行业销售收入分析

图表 30 2019-2022年我国集成电路行业利润总额分析

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202304/354477.html>